

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 5 月 6 日 (06.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/040275 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C08L 59/00, C08G 2/30
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/015580
- (22) 国際出願日: 2004 年 10 月 21 日 (21.10.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2003-364175
2003 年 10 月 24 日 (24.10.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭化成ケミカルズ株式会社 (ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008440 東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小松 純夫 (KOMATSU, Sumio) [JP/JP]; 〒7100038 岡山県倉敷市新田 2 4 0 3-1 0 Okayama (JP). 佐々木 幸義 (SASAKI, Yukiyooshi) [JP/JP]; 〒7100847 岡山県倉敷市東富井 1 0 0 5-1 Okayama (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: POLYACETAL RESIN COMPOSITION AND MOLDING THEREOF

(54) 発明の名称: ポリアセタール樹脂組成物及びその成形品

(57) Abstract: A polyacetal resin composition comprising 100 parts by mass of polyacetal resin (A) whose formaldehyde emission exhibited when heated in nitrogen atmosphere at 200°C for 50 min is 100 ppm or less and 0.01 to 5 parts by mass of hydrazide compound (B). From this polyacetal resin composition, despite molding conditions and molding method such that the molding temperature is high or partially the resin temperature is raised, there can be provided a molded article of strikingly low formaldehyde release. Thus, the polyacetal resin composition is applicable to a wide variety of molding conditions and molding methods. The amount of formaldehyde released from the obtained molded article is reduced to a hitherto unattained level of 1 mg/kg as measured in accordance with the method VDA275, so that the molded article can be used in various application fields wherein low VOC is demanded.

(57) 要約: (A) 窒素雰囲気下、200°Cで50分加熱したときのホルムアルデヒド発生量が100ppm以下であるポリアセタール樹脂100質量部、および(B)ヒドラジド化合物0.01~5質量部からなるポリアセタール樹脂組成物は、高い成形温度あるいは部分的に樹脂温度が上がってしまうような成形条件・成形方法においても、ホルムアルデヒド放出量が著しく少ない成形品を提供することができ、幅広い成形条件・成形方法に適用可能である。得られる成形品から放出されるホルムアルデヒドの量はVDA275法による測定で1mg/kgとこれまでに得られていないレベルにまで低減されており、低VOCが要求されている様々な用途において利用可能である。

WO 2005/040275 A1